

IEC 60191-6-18
(First edition – 2010)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES –**

**Part 6-18: General rules for the preparation of
outline drawings of surface mounted
semiconductor device packages –
Design guide for ball grid array (BGA)**

CEI 60191-6-18
(Première édition – 2010)

**NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS
À SEMICONDUCTEURS –**

**Partie 6-18: Règles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des dispositifs à
semiconducteurs pour montage en surface –
Guide de conception pour les boîtiers matriciels
à billes (BGA)**

CORRIGENDUM 1

**3.1
ball grid array
BGA**

Instead of:

"a package that has ..."

read:

"package that has ..."

3.1 NOTE

Instead of:

"...(See Annex A)."

read:

"...(See Bibliography)."

**3.2
plastic ball grid array
P-BGA**

Instead of:

"BGA with an organic substrate"

read:

"BGA with a rigid organic substrate"

**3.1
boîtier matriciel à billes
BGA**

à la place de:

"un boîtier dont les billes métalliques..."

lire:

"boîtier dont les billes métalliques..."

3.1 NOTE

à la place de:

"...(Voir Annexe A)."

lire:

"...(Voir Bibliographie)."

**3.2
boîtier matriciel à billes en plastique
P-BGA**

à la place de:

"boîtier BGA comportant un substrat
organique"

lire:

"boîtier BGA comportant un substrat
organique rigide"